C-13

原子レベルで平坦な r 面配向 Cr₂O₃ 薄膜の作製条件探索

Investigation of Growth Condition for atomically smooth r-plane oriented Cr₂O₃ thin films

黒田卓司¹, 岩田展幸², 高瀬浩一³, 山本寬²

Takuji Kuroda, Nobuyuki Iwata, Koichi Takase, Hiroshi Yamamoto

Abstract: Deposited on the sapphire substrate temperature (580 to840 ° C), oxygen and Ar ratio (0.25 to 10) was deposited Cr2O3. Average surface roughness of the image results for AFM (Ra) was about 20 times coarser changing from 29nm to 840 ° C and 1.577nm for the 580 ° C in the deposition temperature. Changed to two to six hours deposition time. Surface is changed to two to six hours deposition time was smooth. Bragg diffraction peaks of Cr2O3 was formed from the XRD measurements Al2O3 (11⁻⁰²), Cr2O3 (11⁻⁰²) confirmed that. Peak was confirmed substrate and film by reciprocal lattice map. had changed 6-axis from 3-axis from the after deposition. So a normal growth pattern and are thought to have grown in different twin.

1. 背景

強磁性金属/Cr₂O₃積層膜において交換バイアス 磁場(H_{EB})を用いたデバイス作製を目的としている。 Meiklejohn-Bean によると、積層膜界面における反 強磁性(AF)体表面のスピンの大きさに H_{EB} が比例 する^[1]。単結晶と同等な薄膜を作製しても必ず表面 はステップ-テラス構造を持つ。ほとんどの AF 材 料ではステップによって高さの異なったテラスの スピンは反強磁性的に配列している。一方、Cr₂O₃ 薄膜のr面は、その表面がステップ-テラス構造を 示したとしても、すべての面でスピンは強磁性的 に配列しており、大きな H_{EB} を得る可能性をもっ ている。

これまで、サファイア基板上に*r-, a-, c*-面配向の Cr₂O₃薄膜の作製条件最適化を行ってきた。膜厚約 200nmでは、580°C、O₂/Ar=8/2(ccm)、0.2-0.3Paで エピタキシャル成長した^[2,3]。*r*-面配向 Cr₂O₃薄膜表 面は、一つのグレイン内では unit 単位でステップ-テラス構造を示したが、グレイン同士がコアレッ センスした箇所では大きな段差が、出来ていない 箇所では深さ 20-30nmの深い溝が発生した。この 表面では積層膜界面においてトータルの AF スピ ンは打ち消し合い、大きな *H*_{EB}を発生さえること が出来ない。

本研究では、原子レベルで平坦な表面を持つr 面配向 Cr₂O₃薄膜が得られる作製条件を更に追求 したので報告する。

2. 実験方法·評価方法

r 面サファイア基板をアセトン、エタノールで洗 浄し、12 時間アニール処理を行った。DC-RF マグ ネトロンスパッタ法を用いて成膜を行った。成膜 条件は基板温度 580, 620, 660,720,840℃、導入ガス O₂/Ar 比を 0.25 (2/8ccm), 1.0 (12/12ccm),

2.0(24/12ccm),5.0(30/6ccm),10(30/3ccm)とした。成膜時間は2時間とし、成膜時間6時間の場合でも成膜を行った。成膜後酸素0.1MPa中で温度を低下させた。評価は、原子間力顕微鏡(AFM)、X線回折(XRD)を用いた。

結果・考察

表面像を Fig.1 に示す。成膜条件(基板温度、成膜 雰囲気)はそれぞれ、(a) 580℃、O₂/Ar = 2/8 (ccm)・ 0.31Pa、(b) 660℃、O₂/Ar = 24/12 (ccm)・0.46Pa であ る。(a)500×500 nm²程度のコアレッセンスしたグレ インが一面に分布していた。一つのグレイン内で は約 0.3 nm の段差が、コアレッセンスしているグ レイン間では 1-1.5 nm の段差が確認できた。平均 面荒さ Ra は 1.6 nm であった。コアレッセンス出来 なかったグレイン間には深い溝が発生し深さは 15-20 nm であった。(b)では溝が深く(40-60 nm)なり 発生面積も増大した。グレイン表面では 1-2 nm の 段差が発生した。

r 面配向 Cr₂O₃薄膜の XRD 結果において、Fig.2 に成膜温度 580℃のときの XRD(20-0)パターンを示 す。(2204)から見積もった格子間隔は 0.1817 nm と なってバルク値と一致した。次に成膜温度に対す る半値幅と平均面粗さ Ra のプロット図を Fig.3 に 示す。(2204)Bragg 反射に関するロッキングカーブ の半値幅は基板温度 580 ℃ では 0.54°、660 ℃ では 0.35°であった。表面温度が高温になれば一つのグ レインが大きくなりグレイン同士がコアレッセン スし表面は悪化するがその大きなグレインのみを 考えたとき、表面温度が高くなるにしたがってグ レイン自体は熱により粒成長し大きくなるため成 膜温度を上げることで結晶性の向上に繋がったと 考えている。

次に c 面配向 Cr₂O₃ 薄膜(01110)面の逆格子マップ を Fig.4、c 面配向 Cr₂O₃ 薄膜(10110)面の逆格子マ ップを Fig.5 に示す。基板ピークの位置と薄膜ピー クの位置がずれている。このことから格子定数が 緩和し Cr₂O₃ が基板の影響を受けずにバルクとし て成長していると考えている。また測定面により 基板ピークしか現れない面と基板ピークと薄膜ピ ークの両方が現れる面を周期的に確認した。この ことから成膜前は3回軸であったが成膜後では6 回軸に変化した。よってツインに配向していると 考えている。

^{4.}まとめ

^{1:}日大理工・学部・子情2:日大理工・教員・子情3:日大理工・教員・物理

基板温度を上昇させ、酸素欠損を補うために高酸 素分圧下で成膜を行った。表面形状は荒れたもの の結晶性が向上していることがわかった。Cr₂O₃は サファイアに対し+4.1%の格子ミスマッチがある。 この大きなミスマッチが原因で lnm 程度から膜は 緩和しグレイン成長が開始している^[1,2]。基板温度 が高温になればその様子は顕著に表れグレイン間 により大きな溝ができたと考えている。原子レベ ルで平坦なr面配向 Cr₂O₃薄膜を得るためには格子 ミスマッチをどのように緩和させるかが重要であ る。



Fig.1 Substrate temperature(a)580 $^{\circ}C$ (b)660 $^{\circ}C$ surface image of $Cr_{2}O_{3}$ thin films



Fig.2 XRD(20-0) of Substrate temperature 580 °C







4. 参考文献

- [1] X.Chen et al., Appl. Phys. Lett. 89(2006)202508.
- [2] T.Asada, et al., Jpn. J. Appl. Phys. 47(2008) 546-549.
- [3] N.Iwata, et al., *Mater. Res. Soc. 2007 Fall Proc.* 1034 (2008) K10-67.

謝辞

本研究は科研費・若手研究(B)(21760013)、日本大 学 N.研究プロジェクト、及び日本大学理工学部プ ロジェクト研究の助成を受けたものである。